Tema 3: Jerarquía de Memorias

Conceptos Avanzados de Memoria Principal

Departament d'Arquitectura de Computadors

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

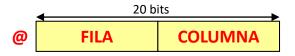


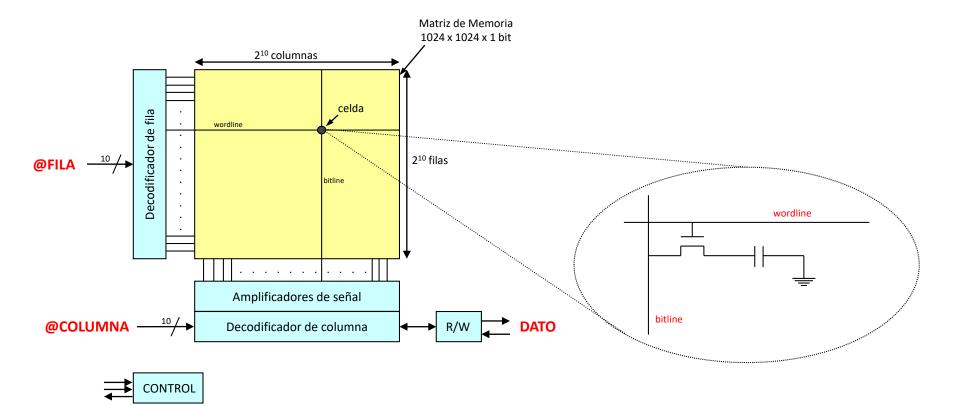


Índice

- Memoria Principal
- Conceptos Básicos Memoria Cache
- Memoria Virtual
- Conceptos Avanzados Memoria Cache
- Memoria Principal
- Conceptos Avanzados Memoria Principal
 - Introducción
 - Estructura interna de una DRAM actual
 - Accesos múltiples
 - Organización de la Memoria Principal
 - Refresco en una DRAM
 - Detección y Corrección de Errores
- Juntándolo todo: Visión General de la Jerarquía

Estructura básica de una DRAM

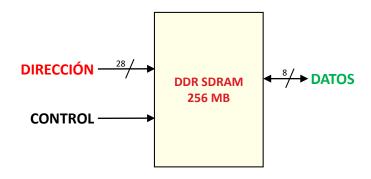




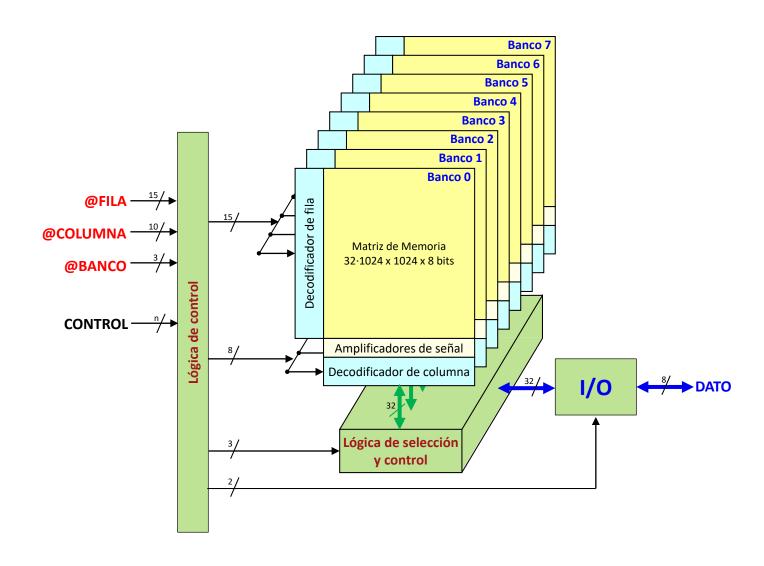
Estructura actual de una DRAM

- Una característica fundamental de las DRAM actuales es que están divididas en bancos.
- Los bancos permiten:
 - Realizar accesos concurrentes a diferentes bancos
 - Ocultar la precarga
 - Ocultar el refresco
 - Tener arrays de memoria más pequeños:
 - ✓ Tiempo de acceso ↓
 - ✓ Consumo de energía↓

- Por ejemplo, una DDR3 de 256 MB tiene:
 - 8 bancos de 32 MB
 - Cada banco tiene 32 K filas por 1K columnas de 1 byte.

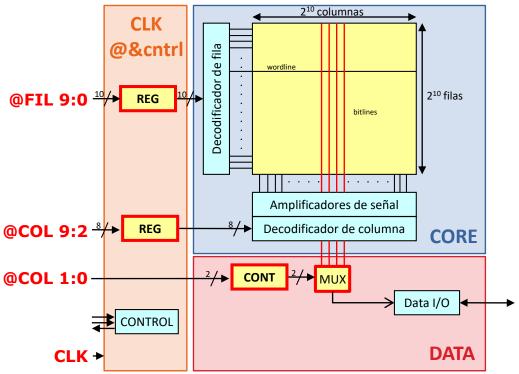


Estructura actual de una DRAM



Variantes de SDRAM

■ SDR (Single Data Rate), DDR (Double Data Rate), DDR2, DDR3, DDR4

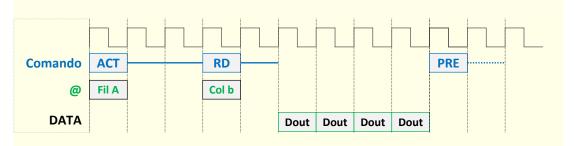


Estándar	CORE (MHz)	BUS CLK (MHz)	Prefetch	DATA RATE M datos / segundo
SDRAM	1x	1x	1n	1x
	100-166	100-166		100-166
DDR	1x	1x	2n	2x
	133-200	133-200		266-400
DDR2	1/2x	1x	4n	2x
	133-200	266-400		533-800
DDR3	1/4x	1x	8n	2x
	133-200	533-800		1066-1600
DDR4	1/8x	1x	8n *	2x
	133-200	1066-1600		2133-3200

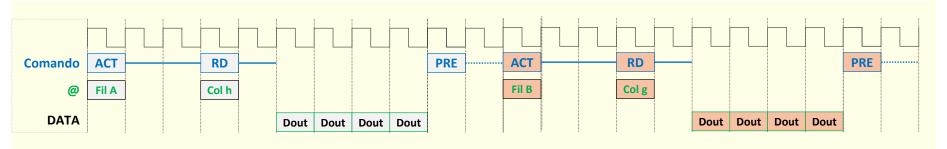
^{*} DDR4 mantiene el prefecth de DDR3 y añade el concepto de *Bank Group* (que no veremos). Para conseguir el ancho de banda (columna *Data Rate*) es necesario entrelazar entre *bank groups*.

Accesos a una DRAM con 1 banco

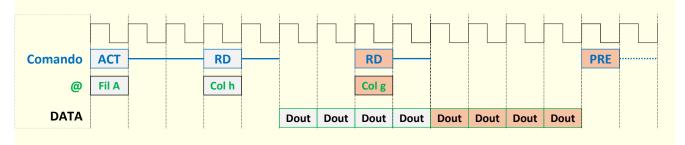
Lectura de un bloque de memoria (Fila A, columna b)



Lectura de 2 bloques de memoria en Filas diferentes (Fila A, columna h y Fila B, columna g)



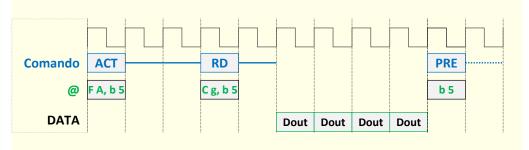
Lectura de 2 bloques de memoria en la misma página (Fila A, columna h y Fila A, columna g)



- 32 bytes por bloque
- ACT: 3 ciclos
- WR, RD: 2 ciclos
- PRE: 2 ciclos
- Transferencia: 8B por ciclo

Accesos a una DRAM con múltiples bancos

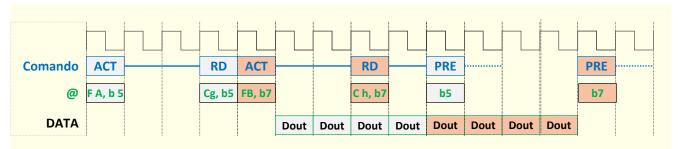
Lectura de un bloque (Banco 5, Fila A, Columna g)



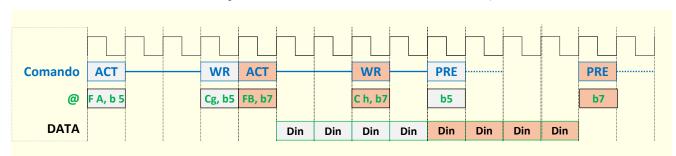
En una DRAM real existen bastantes restricciones que no hemos tenido en cuenta, p.e.:

- Entre una lectura y una escritura hay que esperar N ciclos.
- Entre 2 ACT consecutivos a bancos diferentes han de pasar M ciclos.

Lectura de 2 bloques en bancos diferentes (Banco 5, Fila A, Columna g y Banco 7, Fila B, columna g)



Escritura de 2 bloques en bancos diferentes (Banco 5, Fila A, Columna g y Banco 7, Fila B, columna g)

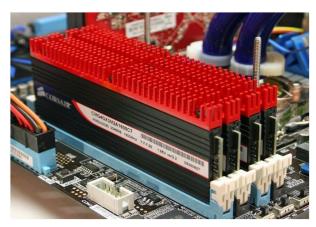


- 32 bytes por bloque
- ACT: 3 ciclos
- WR, RD: 2 ciclos
- PRE: 2 ciclos
- Transferencia: 8B por ciclo

Organización de la Memoria Principal

¿Qué tenemos aquí?

- 8GB de memoria DDR3 1600 MHz
- Direcciones de 33 bits

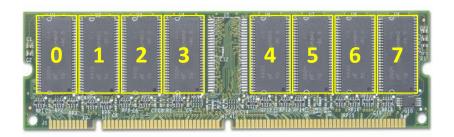


www.blog.corsair.com

¿Cómo está organizado?

- Canales (2)
- DIMMs (2 por canal)
- Chips (8 por DIMM)
- Bancos (8 por chip)
- Filas (32·1024 por Banco)
- Columnas (1024 por Fila)
- 1 byte por columna
- ¿Dónde esta la dirección 0x1DF038A6B?
- Dada una dirección, ¿cómo identificamos canal, DIMM, chip, …?

Organización de la Memoria Principal

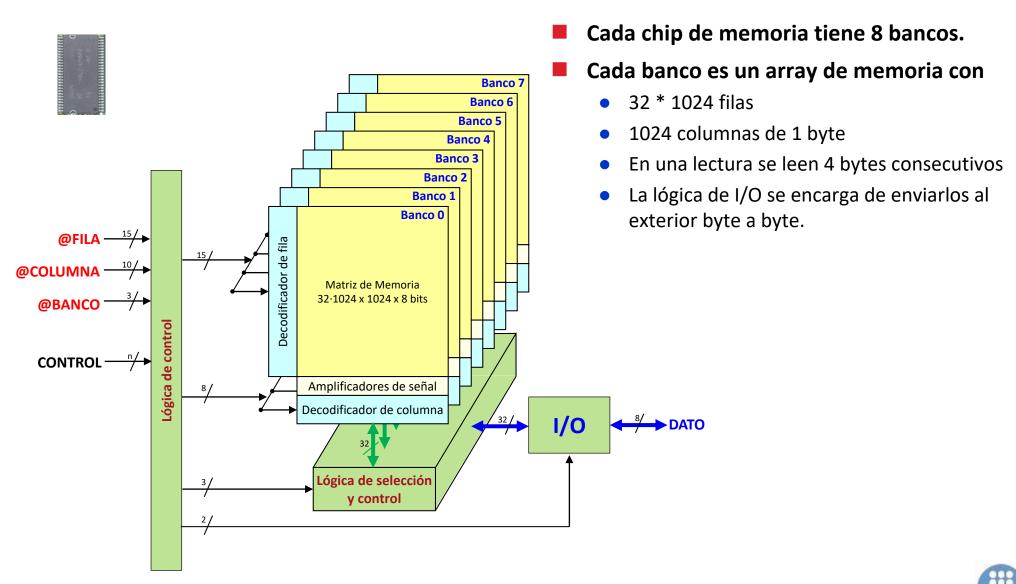


- La Memoria Principal utiliza DIMMS (Dual Inline Memory Modules).
- A nivel de ejemplo, un DIMM podría tener las siguientes características:
 - 2GB de capacidad (requiere 31 bits de dirección)
 - Permite leer 64 bits (8 bytes) de datos en un acceso individual
 - 8 chips

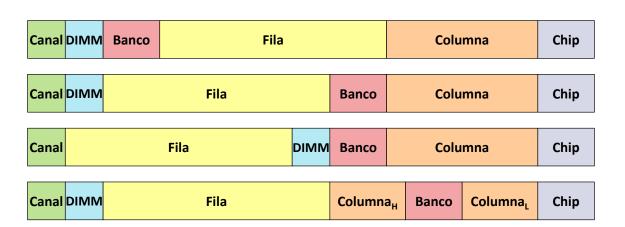


- Cada DIMM de memoria tiene un número determinado de chips.
- A nivel de ejemplo, un chip podría tener las siguientes características:
 - 256 MB de capacidad (requiere 28 bits de dirección)
 - Permite leer 8 bits (1 byte) de datos en un acceso individual
 - 8 bancos

Organización de la Memoria Principal



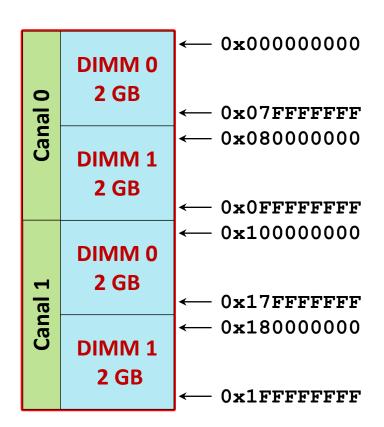
- Nuestra memoria tiene una capacidad de 8GB (33 bits de dirección)
- En nuestra Memoria tenemos:
 - Canales (2): 1 bit para el canal
 - DIMMs (2 por canal): 1 bit para el DIMM
 - Chips (8 por DIMM): 3 bits para el chip
 - Bancos (8 por chip): 3 bits para el banco
 - Filas (32·1024 por Banco): 15 bits para la fila
 - Columnas (1024 por Fila): 10 bits para la columna
- Existen muchas posibilidades válidas:



i El rendimiento del Sistema de Memoria está muy influenciado por esta decisión!

El mapa de memoria viene determinado por esta descomposición:

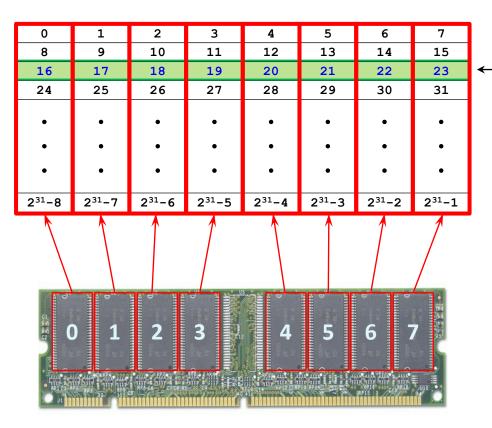




Es imprescindible que los bits bajos de la dirección seleccionen el chip dentro del DIMM

→ MEMORIA ENTRELAZADA

Por ejemplo, las direcciones en el DIMM 0 del Canal 0 se distribuyen así:



La memoria entrelazada permite realizar accesos de 64 bits de ancho.

Canal, DIMM, Banco, Fila, Columna

Chip

Posiciones consecutivas de memoria se encuentran en el mismo «canal, DIMM, banco, fila y columna» de chips diferentes.

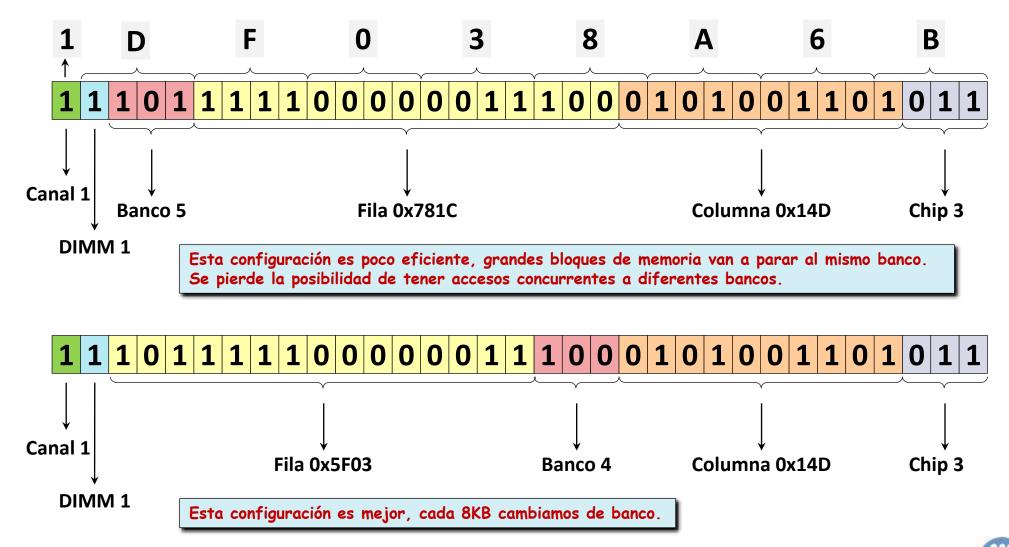
Todos los accesos a Memoria Principal leen (o escriben) bloques de memoria.

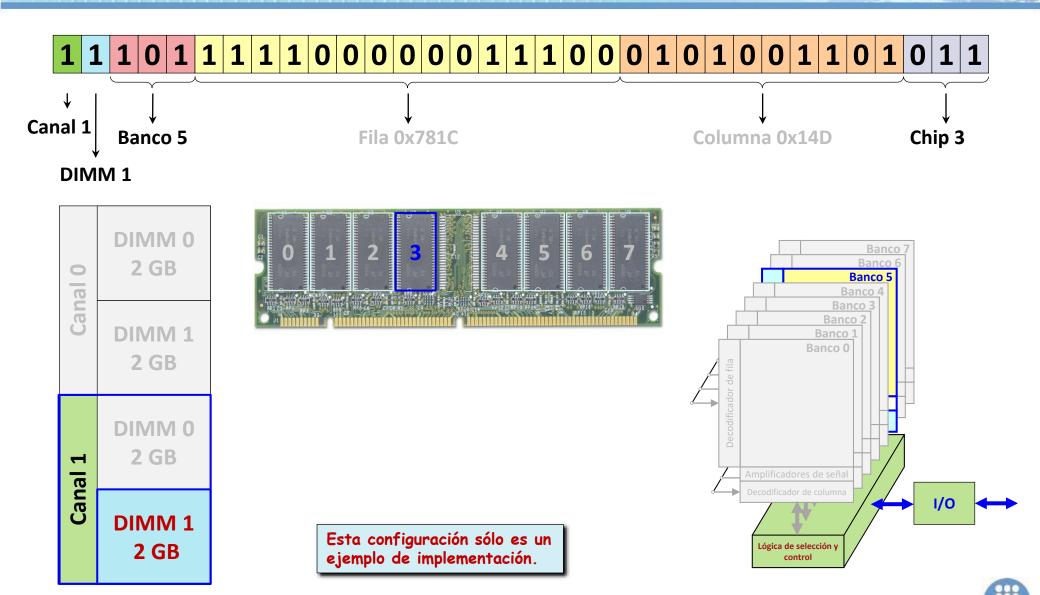


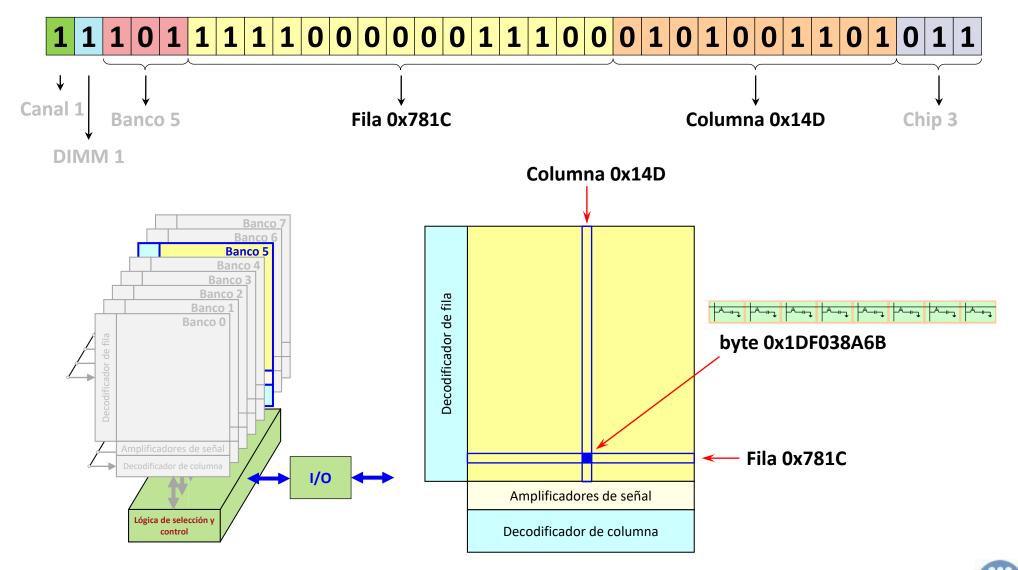
- Las DRAM actuales permiten leer (o escribir) de forma muy eficiente ráfagas de datos.
- Para que esas ráfagas coincidan con bloques de memoria es imprescindible que el campo correspondiente al byte dentro del bloque corresponda a los bits que seleccionan chip y columna_L.

 #bloque= (Canal, DIMM, Banco, Fila, Columna_L) Col_L Chip
- Por ejemplo, con bloques de 32 bytes, el bloque 0 se encuentra en el canal 0, DIMM 0:

0 8 16 24	1 9 17 25	2 10 18 26	3 11 19 27	4 12 20 28	5 13 21 29	6 14 22 30	7 15 23 31	Para leer un bloque de 32 bytes necesitamos una ráfaga de 4 accesos.
•	•	•	•	•	•	•	•	Comando ACT RD PRE PRE
2 ³¹ -8	2 ³¹ -7	2 ³¹ -6	2 ³¹ -5	2 ³¹ -4	2 ³¹ -3	2 ³¹ -2	2 ³¹ -1	© Fil A Col b 0:7 8:15 16:2324:31

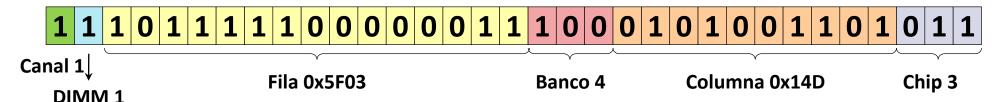






Lectura línea

- La transmisión de datos entre MP y MC se hace por bloques completos
- Ejemplo: 32 bytes por bloque, acceso provocado por un fallo en la dirección 0x1DF038A6B



Hay que leer todos los bytes del bloque:



■ Si transferimos el bloque en orden hay que iniciar el acceso con la siguiente dirección:



Si transferimos en primer lugar el dato que ha provocado en fallo, la dirección es:

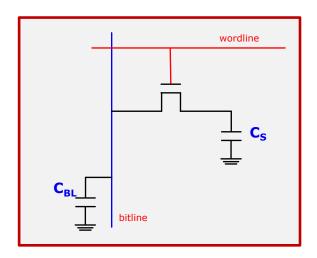


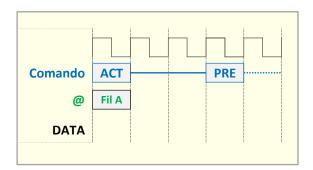
Problema del refresco en una DRAM

- Cada celda de una DRAM equivale a un condensador, como tal, va perdiendo carga de forma exponencial:
 - Corriente de fuga.
 - La lectura es destructiva.
- Para evitar la perdida de información almacenada en las celdas, la carga debe regenerarse periódicamente

\rightarrow REFRESCO

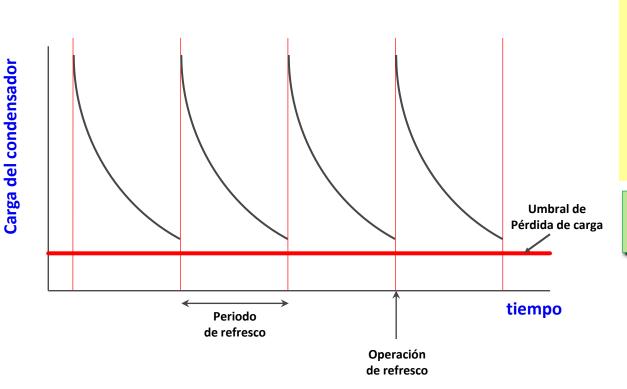
- El refresco hay que aplicarlo a todas las celdas de la memoria. Se aplica fila a fila.
- El refresco de la fila A se puede hacer con un ACT y una PRE.
- Existen comandos especiales para hacer el refresco.
 - Refrescan todos los bancos a la vez.
 - La propia memoria controla que fila hay que refrescar.





Problema del refresco en una DRAM

- Actualmente el refresco es una operación estandarizada establecida por el JEDEC (Junction Electronic Devices Engineering Council)
 - Periodo de refresco de 64ms.
 - Si tenemos 32·1024 filas, en media, hay que lanzar una operación de refresco cada 2μs.



- Frecuencia: 1 GHz
- Coste refrescar fila: 20 ciclos
- Cada 64ms se pierden 655360 ciclos.
- Se pierden 10,2·10⁶ ciclos por segundo.
- Si el refresco NO se puede solapar, se pierde el 1% del tiempo refrescando la memoria.

iEl coste de refrescar la memoria no es despreciable!

Al acceder a memoria se pueden producir errores:



- Estos errores se deben a diversas causas:
 - Interferencias electrónicas o magnéticas (transitorios)
 - Problemas de transmisión de datos (transitorios)
 - Problemas hardware (permanentes), como en cualquier otro chip y por las mismas causas.

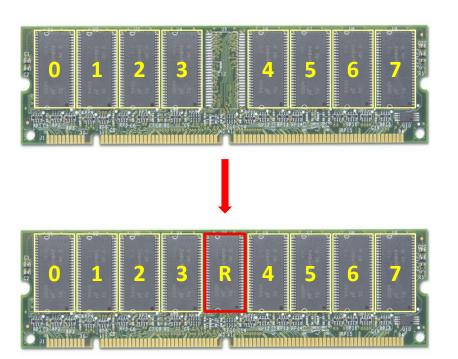
En el IBM Watson Research Center se midió para una muestra de DRAMs clónicas una tasa de error de 5950 fallos cada 109 horas de funcionamiento a nivel del mar (1 fallo cada 19 años, 2 meses, 7 días y 19 horas). La misma prueba en una mina, bajo una capa de rocas de 15 metros, no produjo ningún error. Estos errores son debidos a los rayos cósmicos.



En una instalación como el BSC con 165888 procesadores GPP y 390 Tbytes de MP, contando un mínimo de 8 chips de memoria por procesador se produce un fallo cada 7,5 minutos (192 por día, 5760 al mes, 70080 al año, ...)

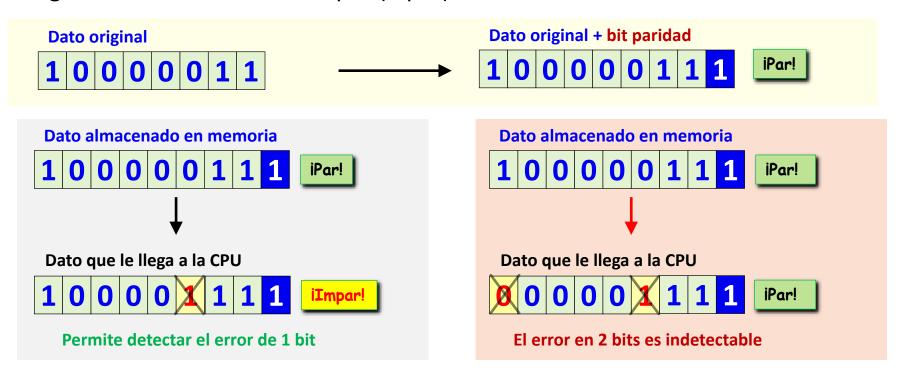
- En algunas instalaciones los errores han de estar bajo control.
- Los errores permanentes sólo se resuelven sustituyendo el elemento dañado.
- Los fabricantes de memoria diseñan sistemas que permiten detectar y en algunos casos corregir los errores transitorios.

→ AÑADIR INFORMACIÓN REDUNDANTE



Bit de Paridad

El sistema más simple es añadir 1 bit, de tal forma que cada porción de información tenga SIEMPRE un número impar (o par) de 1's.



Este sistema sólo sirve para detectar un número impar de errores. No permite corregir errores.

Código Hamming (7, 3): 4 bits de datos y 3 redundantes

Bits redundantes: 1, 2, 4

Bits de datos: 3, 5, 6 y 7

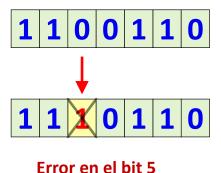
7	6	5	4	3	2	1	
111	110	101	100	011	010	001	
b3	b2	b1	p2	b0	p1	p0	Palabra de 7 bits
11 <mark>1</mark>		10 <mark>1</mark>		011		001	n0 = h2 you h1 you h0
b3	1	b1	1	b0 -	p0	p0 = b3 xor b1 xor b0	
1 <mark>1</mark> 1	1 <mark>1</mark> 0			011	010		n1 = h2 vor h2 vor h0
b3	b2	-	-	b0	p1	-	p1 = b3 xor b2 xor b0
1 11	1 10	1 01	1 00				n2 - h2 vor h2 vor h1
b3	b2	b1	p2	_	_	-	p2 = b3 xor b2 xor b1

7 (6	5	4	3	2	1	
1 1	1	0	p2	1	p1	p0	Palabra de 7 bits
1	-	0	-	1	-	0	p0 = 1 xor 0 xor 1 = 0
1 3	1		-	1	1	-	p1 = 1 xor 1 xor 1 = 1
1 1	1	0	0	-	-	-	p2 = 1 xor 1 xor 0 = 0

Posibles implementaciones								
Bits Paridad	Bits Datos	total						
3	4	7						
4	11	15						
5	26	31						
6	57	63						
7	120	127						
m	2 ^m -m-1	2 ^m -1						

Código Hamming (7, 3): 4 bits de datos y 3 redundantes

Permite corregir un error en 1 bit.



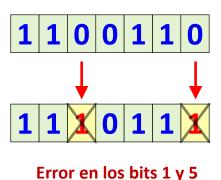
b3	b2	b1	p2	b0	р1	p0	Test Homening
7	6	5	4	3	2	1	Test Hamming
1	1	1	0	1	1	0	
1	-	1	-	1	-	0	T0 = p0 xor b3 xor b1 xor b0 = 0^1^1^1 = 1
1	1	-	-	1	1	-	T1 = p1 xor b3 xor b2 xor b0 = 1^1^1^1= 0
1	1	1	0	-	-	-	T2 = p2 xor b3 xor b2 xor b1 = 0^1^1^1 = 1

El test Hamming da T2T1T0=101, indicando que el error está en el bit 5.

Si T2T1T0=000 no ha habido ningún error.

Código Hamming extendido (7, 3) + 1 bit de paridad.

El código Hamming no funciona cuando se produce un error en 2 bits.

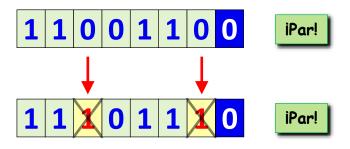


b3	b2	b1	p2	b0	р1	p0	Test Hamming
7	6	5	4	3	2	1	iest nanning
1	1	1	0	1	1	1	
1	-	1	-	1	-	1	T0 = p0 xor b3 xor b1 xor b0 = 1^1^1^1 = 0
1	1	-	-	1	1	-	T1 = p1 xor b3 xor b2 xor b0 = 1^1^1^1= 0
1	1	1	0	-	-	-	T2 = p2 xor b3 xor b2 xor b1 = 0^1^1^1 = 1

El test Hamming da T2T1T0=100, indicando que hay un error en el bit 4 (¿?).

■ Añadiendo un bit de paridad es posible detectar un error en 2 bits o corregir un error de 1 bit.

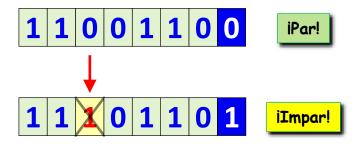
Código Hamming extendido (7, 3) + 1 bit de paridad.



Error en los bits 1 y 5

No hay error de paridad. El test Hamming da T2T1T0=100 Esto implica que se ha producido un error en 2 bits.

No se puede recuperar.



Error en el bit 5

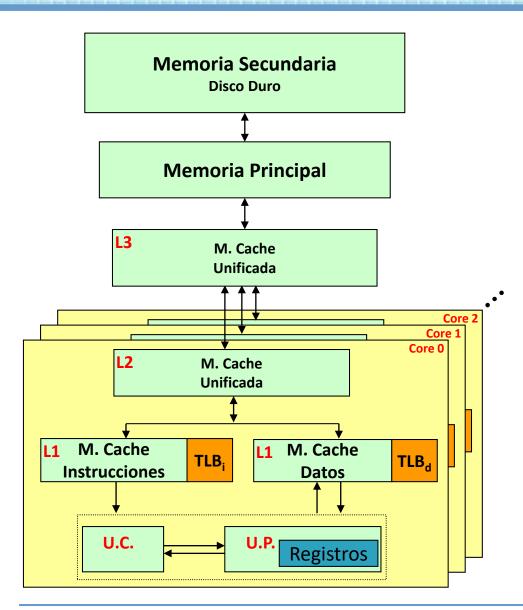
Error de paridad. El test Hamming da T2T1T0=101 Esto implica que se ha producido un error en el bit 5.

Se puede recuperar.

Memoria ECC (Error Correction Code)

- La memoria que incluye estos mecanismos se utiliza exclusivamente en servidores y estaciones de trabajo de gama alta.
- Basado en códigos de Hamming.
 A cada porción de datos se añade información redundante que permite detectar y corregir errores.
- El código ECC más utilizado en memorias es el SEC-DED (Single Error Correction – Double Error Detection).
 Permite corregir 1 error o detectar 2 en la misma porción de datos.
- En DIMMs de memoria se suele utilizar un código extendido (71, 64) + bit de paridad.
 72 bits totales, con 64 bits de datos y 8 redundantes.
 Perfecto para utilizar en un DIMM con 9 chips de 8 bits de ancho.

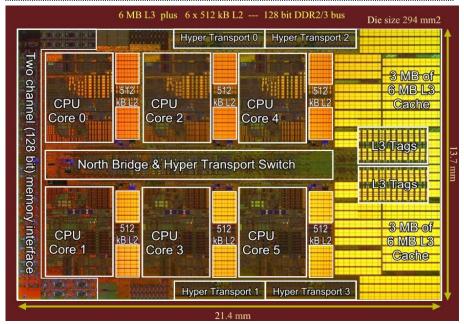
Juntándolo todo



Ejecución de instrucción incl (%ebx)

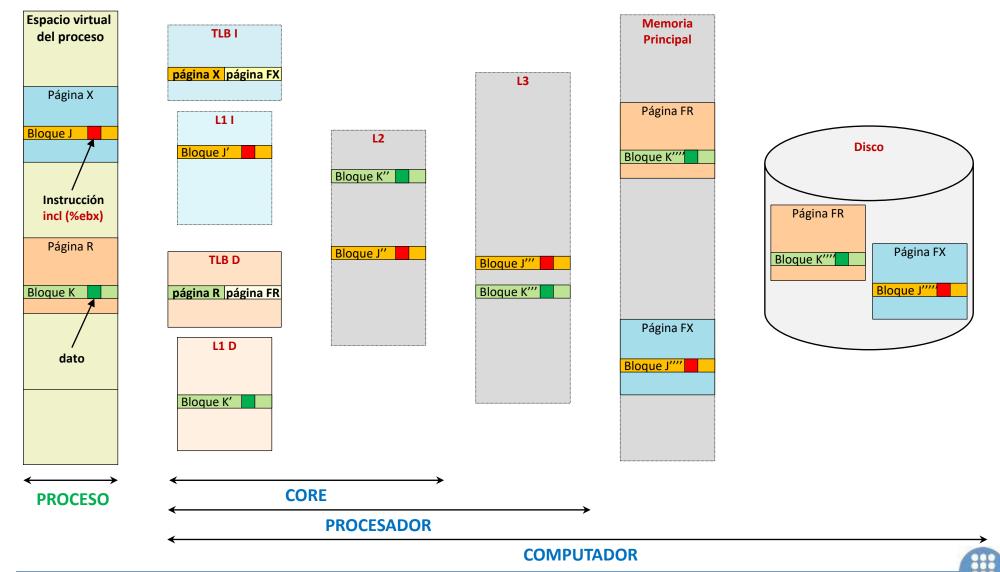
En el **PEOR CASO** puede provocar:

- Al leer instrucción: fallo TLBi, fallo página (acceso a disco), fallo L1 instrucciones, fallo L2, fallo L3
- Al leer dato: fallo TLBd, fallo página (acceso a disco), fallo L1 datos, fallo L2, fallo L3
- Al escribir dato: acierto TLBd, acierto L1 datos



The Istanbul Opteron die. Source: AMD

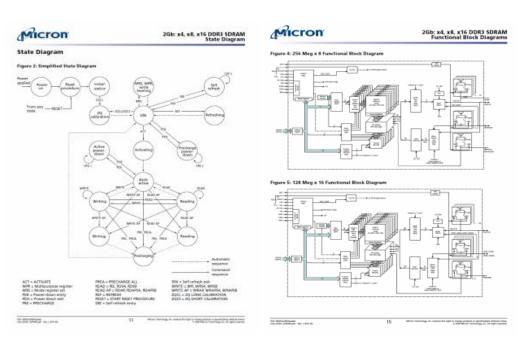
Juntándolo todo

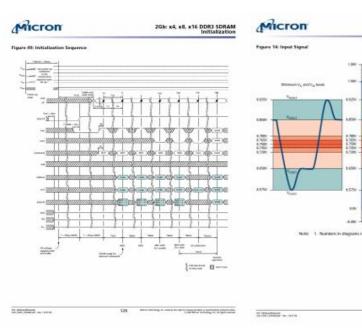


El mundo real

- La vida real es mucho más compleja.
- Detalles de la DDR3 SDRAM MT41J512M4 de Micron.

Así durante 207 páginas...





Imágenes obtenidas en www.micron.com